

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容或產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零四年三月三十一日止三個月業績公佈

本公司謹於今日公佈截至二零零四年三月三十一日止三個月的未經審核經營業績。銷售額由上季的145,000,000元增至二零零四年首季的166,00,000，增幅31.1%。經營溢利由上季的4,600,000元增至二零零四年首季的2690,00,000元，增幅481.3%。毛利率由上季的21.2%增至二零零四年首季的32.2%。

以下為本公司於二零零四年四月二十六日就截至二零零四年三月三十一日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。

由於本公司於二零零四年四月二十六日在美國作出報章公佈(現轉載如下)，因此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.0 (1)條及上市協議第2(1)段規定的披露責任而作出本公佈。

以下為本公司於二零零四年四月二十六日就截至二零零四年三月三十一日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數字均以美元列賬。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。

中芯二零零四年首季業績報告

概要

銷售額增至166,000,000元，較二零零三年第四季度上升31.1%。

經營溢利增至269,000,000元，較二零零三年第四季度上升481.3%。

收入淨額增至27,500,000元，較二零零三年第四季度上升152.4%。

晶圓付運增加138%至174,325片8吋等值晶圓；綜合平均售價上升108%至1,004元。

本公司同時於紐約證券交易所及香港聯交所順利完成首次公開招股，成功集資1,017,000,000元。

中國上海、二零零四年四月二十六日、國際主要半導體承包製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所)；香港聯交所)；(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零零四年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。二零零四年首季銷售額由上一季度的145,000,000元增加31.1%至166,000,000元。二零零四年首季經營溢利由上一季度的4,600,000元增加481.3%至269,000,000元。二零零四年首季經常性淨收入由上一季度的10,000,000元增加152.4%至27,500,000元。二零零四年首季毛利率由上一季度的21.2%上升至32.2%。

本公司報告普通股持有人應佔淨收入為1,600,000元，相當於每股0.0033元及每股美國預託股份0.1630元(按全面攤薄基準計算則為每股0.0005元及每股美國預託股份0.0273元)。扣除一項為數4,100,000元的一次性非現金優先股未發盈餘，經常性淨收入應為27,500,000元，相當於每股0.0104元及每股美國預託股份0.175元(按全面攤薄基準計算則為每股0.0017元及每股美國預託股份0.086元)。

「我們很高興二零零四年首季公司業績持續錄得增長」，中芯主席兼行政總裁張汝京博士表示。「本季度，本公司經營業績能夠取得重大增長，有賴產能增加令付運晶圓數量增多，透過採納更先進的製造流程在產品組合中加入更多定價較高的晶圓產品，使平均銷售價不斷提升，以及整體市場環境持續向好」。二零零四年首季期間，我們新增十六名客戶，並從所有市場類別的客戶接獲數量龐大的訂單，其中尤以通訊市場別為然。本公司首季業績表現，包括在二零零四年三月十八日同時在紐約證券交易所及香港聯交所順利完成首次公開招股，成功集資共1,017,000,000元，足以證明我們的業務計劃行之有效，在承包製造業界具有高度競爭力。」

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：二零零四年四月二十六日
時間：上海時間晚上八時正
撥號及登入密碼：美國1-617-401-715(密碼：32233010)或香港452-400-63-444(密碼：32233010)。

二零零四年首季業績公佈網上直播可於「網站」投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的拷貝片。

有關中芯

中芯(紐約交易所)；香港聯交所)；(0 981) 是全球首屈一指的半導體承包製造商之一。作為一家半導體承包製造商，中芯提供以0.35微米至0.13微米技術製造的集成電路。中芯成立於二零零零年四月，是一家開辦群體公司，於中國上海張江高科技園區營運三間10吋晶圓廠。此外，中芯現在在中國北京興建一間12吋晶圓廠。二零零三年五月，中芯一廠獲得向業主交付物業(詳情請參閱國際雜誌報導)。二零零三年年度最佳半導體廠。除製造集成電路以外，中芯亦為客戶提供一應俱全的服務，包括設計服務、光罩製造及晶圓探測測試等。其他資料詳情，請瀏覽。

安全港聲明

(根據1933年有價證券訴訟改革法案)

本新聞發佈可能載有(除歷史資料外)根據1933年有價證券訴訟改革法案所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「估計」、「預計」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，為並非所有前瞻性陳述均包含上述字樣。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期性及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯生產新產品的能力、半導體承包製造服務市場的競爭、市場需求疲弱、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者考慮中芯提交予美國證券交易委員會(「證交會」)的終文件資料，包括其於二零零四年三月十一日以前表格(經修訂)形式提交予證交會的登記聲明，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份。其於二零零四年三月八日以前表格形式提交予香港聯交所的登記聲明，以及中芯亦可不時向證交會及香港聯交所提交的該等其他文件，包括「一表格」。其他未知或不可逆轉的因素可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述。此等陳述僅就本新聞發佈中所載日期(或如無有關日期)則本新聞發佈日期的情況而表述。

除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不更新任何前瞻性陳述。

投資者聯絡資料：

Jimmy Lai
投資者關係部
電話：+62-21-5040-2000，內線16644
傳真：+62-21-5040-3070

Sarina Huang
公共關係部
電話：+62-21-5040-2000，內線10356
傳真：+62-21-5040-2646

Evonne Hwang
投資者關係部
電話：+62-21-5040-2000，內線16275
傳真：+62-21-5040-3070

概要：
以美元為單位(每股盈利除外)

	二零零四年 首季	二零零三年 第四季	季度比較	二零零三年 首季	年度比較
銷售	166,37	145,047	31.1%	34,442	346.3%
毛利	60,156	30,714	5.1%	(25,053)	-
經營開支	(33,313)	(26,077)	27.7%	(13,277)	150.1%
經營溢利	26,843	4,617	481.3%	(38,332)	(88.6%)
其他收入	60	6,260	(0.3%)	340	117.5%
收入淨額 ⁽¹⁾	27,452	10,877	152.4%	(34,052)	-
未發盈餘	(8,613)	(2,531)	644.4%	0	-
普通股持有人應佔淨收入	18,839	8,346	3.2%	(34,052)	-
毛利率	32.2%	21.2%	(65.2%)	74.5	6
經營利潤率	14.4%	3.2%	(7.7%)	44.34	174.3
每股基本盈利 - 每股普通股 ⁽²⁾	\$0.0033	\$0.0167	(50.4434)	(22.174)	13.7%
每股基本盈利 - 每股美國預託股份 ⁽³⁾	\$0.1630	\$4.3334	(53.0%)	(50.4434)	10.2%
每股攤薄盈利 - 每股普通股 ⁽⁴⁾	\$0.0005	\$0.0005	(53.0%)	(50.4434)	10.2%
每股攤薄盈利 - 每股美國預託股份 ⁽⁵⁾	\$0.0273	\$0.0264	(53.0%)	(50.4434)	10.2%
付運晶圓(千片8吋等值)	174,325	153,125	138%	74.5	6
綜合平均售價	\$1,004	\$10	108%	\$4	4
邏輯平均售價 ⁽⁶⁾	\$1,041	\$67	118%	\$635	70.2%
產能使用率	%	7%	98%		

附註：

- 未扣除1,017,000,000元未發盈餘前。
- 按二零零四年首季不包括股息淨收入計算，每股普通股基本盈利為0.0104元。二零零三年第四季每股普通股基本盈利為0.1130元。
- 按二零零四年首季不包括股息淨收入計算，每股美國預託股份基本盈利為0.517元。二零零三年第四季每股美國預託股份基本盈利為5.6440元。
- 按二零零四年首季不包括股息淨收入計算，每股普通股攤薄盈利為0.0017元。二零零三年第四季每股普通股攤薄盈利為0.0007元。
- 按二零零四年首季不包括股息淨收入計算，每股美國預託股份攤薄盈利為0.016元。二零零三年第四季每股美國預託股份攤薄盈利為0.034元。
- 包括銅接連件
- 不包括銅接連件

銷售額增至166,000,000元，較二零零三年第四季度的145,000,000元錄得季度升幅31.1%，並較二零零三年首季的34,400,000元錄得年度升幅466.3%。導致此等上升的主要因素如下：

二零零四年首季產能增加至65,420片8吋晶圓；

晶圓付運增至174,325片，較二零零三年第四季度的153,125片錄得季度升幅138%；

使用率升至5.1%；及

透過在產品組合中陸續加入更多定價較高的晶圓產品，平均售價上升至1,004元，較二零零三年第四季度的10元上升108%。

毛利增至60,200,000元，較二零零三年第四季度的30,700,000元錄得季度升幅5.1%，二零零三年首季則為(25,100,000)元。毛利率由二零零三年第四季度的21.2%上升至二零零四年首季的32.2%。

研發費用增加至16,500,000元，較上季的13,000,000元錄得季度升幅77.1%，主要來自天津七廠的非經常性開業成本。

一般行政費用從12,300,000元減少128%至10,700,000元，主要因外匯變動所致。

銷售及市場推廣費用從2,300,000元減少23.0%至1,700,000元。

經營溢利增至269,000,000元，較二零零三年第四季度的4,600,000元錄得季度升幅481.3%，二零零三年首季則為(34,300,000)元。

二零零四年首季利息收入減少1,500,000元，主要因二零零三年第四季度就本公司出售一系列可轉換優先股而收取非經常性利息收入。二零零四年首季利息支出因資本化利息金額減少而增加1,000,000元。

淨收入增至27,500,000元，較二零零三年第四季度的10,000,000元錄得季度升幅152.4%，二零零三年首季則為(34,100,000)元。普通股持有人應佔淨收入增至1,600,000元，較二零零三年第四季度的(34,100,000)元錄得季度升幅3.2%，二零零三年首季則為(34,100,000)元。

1. 收入分析

銷售分析	二零零四年 首季	二零零三年 第四季	二零零三年 第三季	二零零三年 第二季	二零零三年 第一季
以應用分類					
電腦	25.1%	26.7%	33.3%	4.8%	71.6%
通訊	56.0%	55.8%	48.2%	32.5%	14.5%
消費	12.2%	13.5%	11.7%	11.3%	7%
其他	6.2%	4.0%	6.8%	6.4%	4.2%
以技術分類(僅包括邏輯、記憶及銅接連件)					
0.13μ	10.1%	10.4%	15.0%	13.5%	4.6%
0.15μ	15.7%	17.5%	10.0%	0.0%	0.0%
0.18μ	44.4%	34.7%	1.7%	10.5%	2.7%
0.25μ	13.3%	10.6%	33.7%	57.4%	42.5%
0.35μ	21.5%	26.8%	21.6%	18.6%	50.4%
以邏輯分類 ⁽¹⁾					
0.13μ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.15μ	4.4%	1.1%	0.3%	0.1%	0.0%
0.18μ	58.5%	52.1%	40.3%	33.3%	13.7%
0.25μ	5.0%	3.4%	15.1%	7.6%	35.5%
0.35μ	32.1%	41.8%	44.3%	5.0%	50.4%
以裝置分類					
邏輯(僅包括銅接連件)	72.4%	71.6%	60.0%	43.3%	23.6%
記憶體	21.6%	24.5%	34.0%	53.0%	72.2%
其他(光罩製造及探測)	6.0%	3.1%	6.0%	3.7%	4.2%
以客戶類別分類					
非廠房半導體公司	36.6%	30.8%	31.1%	34.2%	44.1%
集成裝置製造商	54.0%	62.7%	4.2%	2.1%	41.2%
系統公司及其他	9.4%	6.5%	1.7%	31.1%	42.1%
以地區分類					
北美洲	41.4%	36.2%	38.6%	3.6%	26.6%
台灣	13.3%	5.2%	24.8%	42.1%	67.2%
南韓	12.2%	17.7%	11.4%	10.4%	0.7%
日本	16.3%	15.5%	13.3%	4.2%	2.7%
歐洲	15.1%	1.7%	7.1%	1.6%	0.1%
亞太區(不包括日本、南韓及台灣)	1.7%	1.4%	2.0%	2.1%	2.7%

附註：

- 不包括0.13μ 銅接連件

相較二零零三年第四季度而言，二零零四年首季通訊類別的銷售額較其他應用技術增長更快。

二零零四年首季邏輯晶圓(包括銅接連件)的銷售百分比上升至佔銷售額達72.4%，二零零三年第四季度及二零零三年第一季度則分別為71.6%及73.6%。

二零零四年首季0.18μ 及以下技術的銷售百分比上升至佔銷售額達70.2%，二零零三年第四季度及二零零三年第一季度則分別為62.6%及73.3%。

非廠房公司佔二零零四年首季銷售額36.6%，二零零三年第四季度則佔30.4%。

二零零四年首季源自北美洲客戶的銷售百分比上升至41.4%，二零零三年第四季度則為36.2%。二零零四年首季源自台灣及日本客戶的銷售百分比分別上升至13.3%及16.3%，二零零三年第四季度則分別為5.5%及15.5%。

產能：	二零零四年 首季	二零零三年 第四季
期終每月晶圓計，8吋等值		
廠/(晶圓尺寸)		
一廠(8吋)	31,720	24,000
二廠(8吋)	24,400	21,000
每月晶圓裝配總產能	56,120	4,000
銅接連件：		
三廠(8吋)	300	000
每月銅接連件總產能	300	000

* 截至二零零四年首季度終結時，由於本公司不斷提升一、二及三廠的首次表現，每月產能增加至65,420件晶圓。

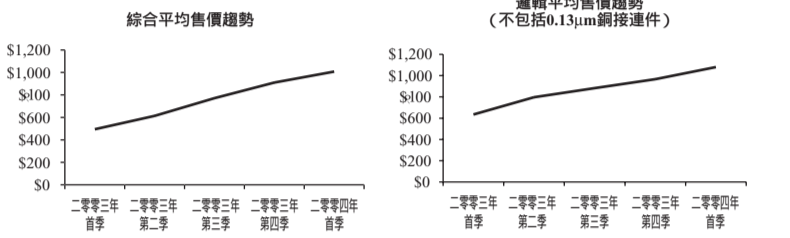
付運及使用率：	二零零四年 首季	二零零三年 第四季	二零零三年 第三季	二零零三年 第二季	二零零三年 第一季
8吋晶圓					
付運晶圓(包括銅接連件)	174,325	153,125	130,740	117,500	74.5
使用率(1)	%	7%	3%	7%	48.6%

附註：

- 使用率按輸出晶圓總額除以估計產能計算

二零零四年首季晶圓付運量為174,325件8吋晶圓，分別較二零零三年第四季度及二零零三年第一季度上升138%及133.7%。

使用率因每季產能首次表現及產品組合而變化。



二零零四年首季綜合平均售價分別由二零零三年第四季及二零零三年第一季度的10元及4元上升至1,004元。主要原因在於在本公司轉而生產更多邏輯產品，減產晶圓。採納更先進及更高利潤的處理技術，半導體產品市場價格整體上升以及本公司的市場地位。

二零零四年首季邏輯平均售價(不包括0.13μ 銅接連件)分別由二零零三年第四季及二零零三年第一季度的1.04元及67元上升至635元。主要原因在於本公司轉而生產更先進(0.18μ)的邏輯晶圓，採納更先進及更高利潤的處理技術，半導體產品市場價格整體上升以及本公司的市場地位。

2. 詳細財務分析

毛利分析	二零零四年 首季	二零零三年 第四季	季度比較	二零零三年 首季	年度比較
以千美元計					
銷售成本	126,741	114,333	10.1%	63,455	7.7%
折舊	64,423	58,130	10.7%	28,511	126.0%
其他製造成本	62,358	56,140	11.1%	34,494	78.2%
毛利	60,156	30,714	5.1%	(25,053)	-
毛利率	32.2%	21.2%	(65.2%)		

毛利增至60,200,000元，較二零零三年第四季度的30,700,000元錄得季度升幅5.1%，二零零三年首季則為(25,100,000)元。錄得升幅主要由於晶圓付運增加以及產能提升、使用率上升，以及透過在產品組合中加入更多定價較高的晶圓產品，使平均銷售價上升。

毛利率由二零零三年第四季度的21.2%上升至二零零四年首季的32.2%。

經營開支分析

以千美元計	二零零四年 首季	二零零三年 第四季	季度比較	二零零三年 首季	年度比較
經營開支	(33,313)	(26,077)	27.7%	(13,277)	150.1%
一般及行政	(10,644)	(12,251)	(12.8%)	(3,167)	172.1%
銷售及市場推廣	(1,747)	(2,270)	(23.0%)	(2,145)	(88.6%)
研究及開發	(16,540)	(3,411)	77.1%	(6,331)	160.1%
遞延股份報酬攤銷	(4,334)	(2,235)	4.1%	(617)	3.5%

總經營開支增至33,300,000元，較二零零三年第四季度的26,100,000元錄得季度升幅27.7%，並較二零零三年首季的13,300,000元錄得年度升幅150.1%。

研究及開發費用增至16,500,000元，較上季的13,000,000元錄得季度升幅77.1%，主要來自天津七廠的非經常性開業成本。

遞延股份報酬攤銷增至4,300,000元，較上季的2,200,000元錄得季度升幅4.1%，主要因就完成收購七廠向僱員發行購股權所致。

非經營項目

以千美元計	二零零四年 首季	二零零三年 第四季	季度比較	二零零三年 首季	年度比較
其他收入，淨額	60	6,260	(0.3%)	340	117.5%
利息收入	1,444	2,413	(50.3%)	678	184.1%
利息支出，扣除政府補貼	(2,743)	(26)	1.64%	(146)	1777.1%
其他，淨額	1,964	4,203	(55.5%)	(252)	-
未發盈餘	(8,613)	(2,531)	(644.4%)	0	-

二零零四年首季利息收入減少1,500,000元，主要因二零零三年第四季度就本公司出售一系列可轉換優先股而收取非經常性利息收入。二零零四年首季利息支出因資本化利息金額減少而增加1,000,000元。

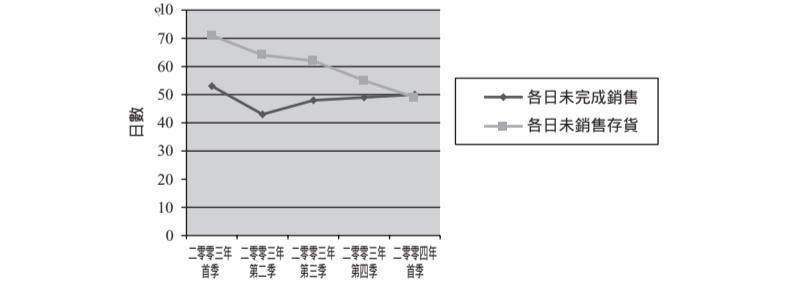
屬非現金及非經常性開支項目的未發盈餘，指可購買本公司於二零零四年首季所發行一系列可轉換優先股的認股證售價及換股價與其各自公平市值的差額。有關認股證已於本公司首次公開招股結束後屆滿。

3. 流動資金

以百萬美元計	二零零四年 首季	二零零三年 第四季
現金及現金等價物	1,373,072	445,276
短期投資	27,306	27,165
應收賬款	116,812	0,53
存貨	45,47	6,24
其他	50,343	47,74
總流動資產	1,653,052	608,762
應付賬款	3,071	211,762
長期借款的即期部份	5,2	0
其他	48,51	113,66
總流動負債	575,044	325,431
現金比率	2.4	1.4
流動比率	2.7	1.1
流動比率	2.1	2.1

現金及現金等價物由445,300,000元增至1,373,100,000元，主要由於收到首次公開發售所得款項淨額。現金比為2.4倍，仍處於穩健狀況。

應收賬款 / 存貨的每日趨勢



存貨流轉持續有所改善，未銷售存貨的日數由二零零三年第四季的55日減至二零零四年首季的4日。

股本結構

以百萬美元計	二零零四年 首季	二零零三年 第四季
現金及現金等價物	1,373,072	445,276
短期投資	27,306	27,165
長期借款的即期部份	5,2	0
長期借款	3,784	47,61
總借款	4,384	47,61
現金淨額	06,444	(7,520)
股東權益	2,84,431	1,485,115
總借款對權益比率	17.1%	32.3%

總借款由二零零三年第四季的480,000,000元增至二零零四年首季的4,300,000元。